2027年6月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年10月30日

上場会社名　　レーザーテック株式会社　　上場取引所　東
コード番号　　6920　　URL　https://www.lasertec.co.jp/
代表者　　（役職名）代表取締役社長執行役員　　（氏名）仙洞田　哲也
問合せ先責任者　（役職名）執行役員　　（氏名）横川　久　　TEL　045-478-7111

配当支払開始予定日　　ー

決算補足説明資料作成の有無：　有

決算説明会開催の有無　　：　有　　（機関投資家・アナリスト向け）

（百万円未満切捨て）

1. 2027年6月期第1四半期の連結業績（2026年7月1日～2026年9月30日）

(1)連結経営成績（累計）　　（%表示は、対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年6月期第1四半期	40,369	△25.5	15,769	△41.0	14,711	△45.8	10,734	△43.7
2026年6月期第1四半期	54,171	47.5	26,728	67.9	27,141	113.2	19,057	113.4

（注）包括利益　2027年6月期第1四半期　10,319百万円（△46.3%）　2026年6月期第1四半期　19,228百万円（182.9%）

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2027年6月期第1四半期	119.72	119.67
2026年6月期第1四半期	211.46	211.28

(2)連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2027年6月期第1四半期	366,413	239,509	65.4	2,669.93
2026年6月期	336,650	246,850	73.3	2,753.84

（参考）自己資本　2027年6月期第1四半期　　239,509百万円　　2026年6月期　　246,828百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2026年6月期	ー	132.00	ー	197.00	329.00
2027年6月期	ー				
2027年6月期（予想）		140.00	ー	211.00	351.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：　無

3. 2027年6月期の連結業績予想（2026年7月1日～2027年6月30日）

（%表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	290,000	25.8	125,000	18.8	125,000	15.9	90,000	16.2	1,003.27

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：　無

※　注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：　無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：　無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更　：無
② ①以外の会計方針の変更　：無
③ 会計上の見積りの変更　：無
④ 修正再表示　：無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2027年6月期1Q	94,286,400株	2026年6月期	94,286,400株
② 期末自己株式数	2027年6月期1Q	4,579,785株	2026年6月期	4,655,734株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2027年6月期1Q	89,665,323株	2026年6月期1Q	90,124,482株

※　添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。

（決算説明会内容の入手方法について）

当社は、2026年10月30日(金)に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で使用する資料については、開催にあわせて当社ウェブサイトに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1．経営成績等の概況 …… 2
(1)当四半期の経営成績の概況 …… 2
(2)当四半期の財政状態の概況 …… 2
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …… 2
2．四半期連結財務諸表及び主な注記 …… 3
(1)四半期連結貸借対照表 …… 3
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …… 5
四半期連結損益計算書 …… 5
四半期連結包括利益計算書 …… 6
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …… 7
(4)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …… 8
（セグメント情報等の注記） …… 8
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …… 8
（継続企業の前提に関する注記） …… 8
（収益認識関係） …… 9
3．補足情報 …… 10
(1)品目別生産実績 …… 10
(2)品目別販売実績 …… 10

1．経営成績等の概況

(1)当四半期の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、地政学リスクに伴うエネルギー価格の上昇やインフレ圧力、主要国の金融政策動向により先行き不透明な状況が続きました。

当社グループの主要販売先である半導体業界では、AIデータセンターへの旺盛な投資を背景に、CPUやGPU、HBM（広帯域メモリ）など先端半導体の需要が高水準で推移し、デバイスメーカーの設備投資計画はさらに積極化しました。このような状況下、当社グループを取り巻く事業環境は良好に推移し、今期の受注見通しも従来の想定を上回るものとなりました。

当第1四半期連結累計期間の売上高につきましては、概ね当初の想定通り進捗し、403億69百万円（ただし、前年同期比では25.5%減少）となりました。

品目別に見ますと、半導体関連装置が238億49百万円（前年同期比42.9%減少）、その他の製品が5億8百万円（前年同期比134.7%増加）、サービスが160億11百万円（前年同期比31.2%増加）となりました。

連結損益につきましては、営業利益が157億69百万円（前年同期比41.0%減少）、経常利益が147億11百万円（前年同期比45.8%減少）、親会社株主に帰属する四半期純利益が107億34百万円（前年同期比43.7%減少）となりました。

(2)当四半期の財政状態の概況

①財政状態

当第1四半期連結会計期間末における総資産は3,664億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ297億62百万円増加いたしました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産が100億95百万円減少したものの、現金及び預金が192億65百万円、仕掛品が156億円増加したことによるものであります。

負債につきましては、当第1四半期連結会計期間末残高は1,269億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ371億3百万円増加いたしました。これは主に、未払法人税等が70億2百万円減少したものの、前受金が427億90百万円増加したことによるものであります。

株主資本にその他の包括利益累計額を加えた純資産合計は2,395億9百万円となり、また自己資本比率は65.4%となりました。

②キャッシュ・フロー

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ192億65百万円増加し、1,107億68百万円となりました。当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、391億2百万円の収入（前年同期比558.6%増加）となりました。これは主に、前受金の増加額435億77百万円、税金等調整前四半期純利益147億11百万円、売上債権の減少額98億78百万円などの収入要因が、棚卸資産の増加額176億96百万円、法人税等の支払額106億34百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、7億83百万円の支出（前年同期比125.9%増加）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億69百万円、無形固定資産の取得による支出1億84百万円などによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、176億70百万円の支出（前年同期比24.0%減少）となりました。これは主に、配当金の支払額176億57百万円などによるものであります。

(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2027年6月期連結業績予想につきましては、2026年8月6日に公表した予想から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

	前連結会計年度 (2026年6月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	91,503	110,768
受取手形、売掛金及び契約資産	26,963	16,868
仕掛品	122,449	138,050
原材料及び貯蔵品	45,342	47,539
その他	8,854	11,568
貸倒引当金	△31	△21
流動資産合計	295,082	324,772
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	10,503	10,268
機械装置及び運搬具（純額）	3,329	3,102
工具、器具及び備品（純額）	1,809	2,485
リース資産（純額）	136	126
土地	13,146	13,065
建設仮勘定	328	202
有形固定資産合計	29,255	29,252
無形固定資産	1,251	1,215
投資その他の資産		
投資有価証券	1,538	1,292
退職給付に係る資産	130	82
繰延税金資産	8,515	8,886
その他	877	912
投資その他の資産合計	11,061	11,173
固定資産合計	41,568	41,641
資産合計	336,650	366,413

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （2026年6月30日）	当第1四半期連結会計期間 （2026年9月30日）
負債の部		
流動負債		
買掛金	12,534	14,956
未払法人税等	12,767	5,764
前受金	44,284	87,075
繰延収益	7,794	6,702
賞与引当金	87	2,465
役員賞与引当金	818	173
株式給付引当金	―	2,158
その他	8,082	6,645
流動負債合計	86,368	125,941
固定負債		
退職給付に係る負債	501	500
株式給付引当金	2,467	5
役員株式給付引当金	84	85
資産除去債務	257	261
その他	121	109
固定負債合計	3,432	961
負債合計	89,800	126,903
純資産の部		
株主資本		
資本金	931	931
資本剰余金	1,381	1,191
利益剰余金	252,975	246,052
自己株式	△12,977	△12,767
株主資本合計	242,310	235,407
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	999	830
為替換算調整勘定	3,558	3,311
退職給付に係る調整累計額	△40	△39
その他の包括利益累計額合計	4,518	4,102
新株予約権	21	―
純資産合計	246,850	239,509
負債純資産合計	336,650	366,413

(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（単位：百万円）

	前第1四半期連結累計期間 （自　2025年7月1日 至　2025年9月30日）	当第1四半期連結累計期間 （自　2026年7月1日 至　2026年9月30日）
売上高	54,171	40,369
売上原価	21,363	16,333
売上総利益	32,807	24,035
販売費及び一般管理費	6,079	8,266
営業利益	26,728	15,769
営業外収益		
受取利息	35	191
投資有価証券売却益	221	－
為替差益	153	－
補助金収入	－	221
その他	9	15
営業外収益合計	420	428
営業外費用		
自己株式取得費用	5	－
為替差損	－	1,260
固定資産圧縮損	－	195
その他	2	31
営業外費用合計	7	1,487
経常利益	27,141	14,711
税金等調整前四半期純利益	27,141	14,711
法人税、住民税及び事業税	7,702	4,279
法人税等調整額	381	△303
法人税等合計	8,083	3,976
四半期純利益	19,057	10,734
親会社株主に帰属する四半期純利益	19,057	10,734

（四半期連結包括利益計算書）

（単位：百万円）

	前第1四半期連結累計期間 （自　2025年7月1日 至　2025年9月30日）	当第1四半期連結累計期間 （自　2026年7月1日 至　2026年9月30日）
四半期純利益	19,057	10,734
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△96	△169
為替換算調整勘定	265	△247
退職給付に係る調整額	2	1
その他の包括利益合計	171	△415
四半期包括利益	19,228	10,319
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	19,228	10,319
非支配株主に係る四半期包括利益	―	―

(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	前第1四半期連結累計期間 （自　2025年7月1日 至　2025年9月30日）	当第1四半期連結累計期間 （自　2026年7月1日 至　2026年9月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	27,141	14,711
減価償却費	1,199	800
投資有価証券売却損益（△は益）	△221	－
補助金収入	－	△221
固定資産圧縮損	－	195
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△148	△10
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,797	2,380
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△676	△644
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△5	△1
株式給付引当金の増減額（△は減少）	105	△295
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	0
受取利息及び受取配当金	△35	△191
為替差損益（△は益）	240	1,279
売上債権の増減額（△は増加）	4,300	9,878
棚卸資産の増減額（△は増加）	△822	△17,696
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,258	2,497
前受金の増減額（△は減少）	3,653	43,577
その他	△4,948	△6,712
小計	30,321	49,547
利息及び配当金の受取額	35	190
法人税等の支払額	△24,420	△10,634
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,937	39,102
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△314	△569
無形固定資産の取得による支出	△26	△184
差入保証金の差入による支出	△4	△51
補助金の受取額	－	22
投資活動によるキャッシュ・フロー	△346	△783
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△19,300	△17,657
自己株式の取得による支出	△3,926	△2
その他	△12	△11
財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,239	△17,670
現金及び現金同等物に係る換算差額	204	△1,383
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△17,444	19,265
現金及び現金同等物の期首残高	86,087	91,503
現金及び現金同等物の四半期末残高	68,642	110,768

(4)四半期連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等の注記）

当社グループの事業は、検査・測定装置の設計、製造、販売を行う単一のセグメントであるため、記載を省略しております。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループの主たる地域別、収益認識の時期別の収益の分解と主たる製品及びサービスとの関連は次のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間（自　2025年7月1日　至　2025年9月30日）

（単位：百万円）

	製品の販売		サービス	計
	半導体関連装置	その他の製品		
地域別				
日本	2,862	186	969	4,019
韓国	12,440	－	2,022	14,463
台湾	3,210	9	2,839	6,059
その他アジア	4,595	20	1,027	5,644
米国	17,633	－	4,372	22,005
欧州	1,009	－	970	1,979
合計	41,752	216	12,202	54,171
収益認識の時期				
一時点で移転される財又はサービス	37,971	174	6,157	44,303
一定期間にわたり移転されるサービス	3,780	42	6,044	9,868
合計	41,752	216	12,202	54,171

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

当第1四半期連結累計期間（自　2026年7月1日　至　2026年9月30日）

（単位：百万円）

	製品の販売		サービス	計
	半導体関連装置	その他の製品		
地域別				
日本	461	116	1,163	1,741
韓国	3,840	20	3,072	6,933
台湾	4,079	330	4,894	9,304
その他アジア	4,547	40	1,427	6,015
米国	9,893	－	4,461	14,354
欧州	1,027	－	992	2,020
合計	23,849	508	16,011	40,369
収益認識の時期				
一時点で移転される財又はサービス	20,910	470	6,890	28,272
一定期間にわたり移転されるサービス	2,938	37	9,121	12,097
合計	23,849	508	16,011	40,369

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

3. 補足情報

(1)品目別生産実績

第1四半期連結累計期間における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品目		前期	当期	対前年同四半期増減率
		百万円	百万円	%
製品	半導体関連装置	32,843	72,326	120.2
	その他の製品	742	1,189	60.1
	小計	33,585	73,515	118.9
サービス		12,202	16,011	31.2
合計		45,788	89,527	95.5

（注）金額は販売価格で表示しております。

(2)品目別販売実績

第1四半期連結累計期間における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品目		前期	当期	対前年同四半期増減率
		百万円	百万円	%
製品	半導体関連装置	41,752	23,849	△42.9
	その他の製品	216	508	134.7
	小計	41,968	24,357	△42.0
サービス		12,202	16,011	31.2
合計		54,171	40,369	△25.5